(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年4月3日(03.04.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/069762 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/52 (2006.01) *H01L 33/48* (2010.01)
H01L 21/60 (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2024/029001

(22) 国際出願日： 2024年8月14日(14.08.2024)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2023-170164 2023年9月29日(29.09.2023) JP

(71) 出願人: 信越化学工業株式会社(**SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.**) [JP/JP]; 〒1000005 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 (JP).

(72) 発明者: 山 岡 裕 (**YAMAOKA Hiroshi**); 〒2340053 神奈川県横浜市港南区日野中央２丁目２２－５２ ＳＡＬ株式会社内 (JP). 木村 真司(**KIMURA Shinji**); 〒3790224 群馬県安中市松井田町人見１番地１０ 信越化学工業株式会社 シリコーン電子材料技術研究所内 (JP). 小川 敬典(**OGAWA Yoshinori**); 〒1000005 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 信越化学工業株式会社 本社内 (JP).

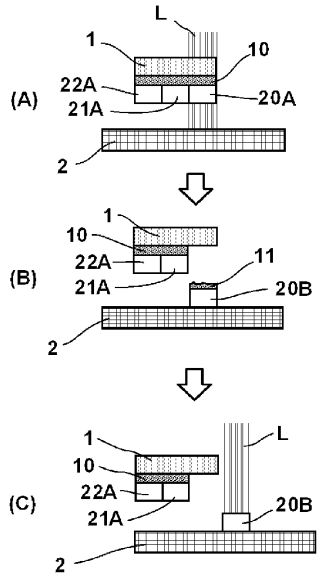
(74) 代理人: 好宮 幹夫, 外 (**YOSHIMIYA Mikio** et al.); 〒1100005 東京都台東区上野７丁目６番１１号 第一下谷ビル８Ｆ (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(54) **Title:** TRANSFER METHOD

(54) 発明の名称： 移載方法

［図1］



(57) **Abstract:** The present invention relates to a transfer method for transferring a plurality of microstructures that are provided on a substrate to another substrate by laser irradiation, the transfer method comprising a transfer step for irradiating a first microstructure with a laser through the substrate and transferring the first microstructure to the other substrate, and an additional irradiation step for irradiating the transferred first microstructure with at least one laser. There is thereby provided a transfer method with which it is possible to remove residue adhering to a microstructure while improving productivity.

(57) 要約：本発明は、基材上に設けられた複数の微小構造体をレーザ照射により他の基材へ移載する移載方法であって、第一の微小構造体に向けて前記基材を通してレーザを照射し、前記第一の微小構造体を前記他の基材へ移載する移載工程、及び、前記移載された第一の微小構造体に向けて少なくとも一回のレーザを照射する追加照射工程を有する移載方法である。これにより、生産性を向上しながら微小構造体に付着した残渣を除去可能な移載方法を提供する。

WO 2025/069762 A1

［続葉有］

(84) 指定国（表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能）: ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）